

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費<sup>#</sup>

\* 只適用於認購1至3手

# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

## 華虹半導體有限公司

Hua Hong Semiconductor Limited

股份編號： 1347 主板

公開發售價

HK\$ 11.15 – 12.20

半導體

## 背景/業務

華虹是全球領先的200mm純晶圓代工廠。根據IBS的資料，按二〇一三年銷售收入總額計算，華虹是全球第二大200mm純晶圓代工廠，而且是世界第六大純晶圓代工廠，按銷售收入計算，華虹於全球整體代工市場的市場份額為1.4%。更多詳情請參閱本招股章程第75頁「行業概覽－代工行業」。華虹主要專注製造特種應用的200mm晶圓半導體。華虹的製造專業知識來自多年來為200mm晶圓的製造研發先進及差異化的技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器及功率器件。華虹的組合亦包括RFCMOS、模擬及混合信號、CMOS圖像傳感器、電源管理及MEMS等多種其他先進工藝技術。於二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年以及截至二〇一三年及二〇一四年六月三十日止六個月，華虹分別產生約3,080萬美元、3,020萬美元、3,030萬美元、1,460萬美元及1,770萬美元的研發開支，分別佔華虹於該等期間銷售收入的5.1%、5.3%、5.2%、5.2%及5.5%。華虹採用自身的專有工藝及技術，為多元化的客戶製造符合其設計規格的半導體，客戶包括(i)集成器件製造商；及(ii)系統及無廠半導體公司。華虹亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致完善的複雜設計。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千美元)	2011	2012	2013
收益	609,844	571,480	584,719
其他(虧損)及收益	50,998	26,492	30,605
除稅前溢利	106,589	67,672	70,813
年度/期內溢利	95,623	59,679	61,849
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.31 – 10.54港元		
歷史備考市盈率	24.05 - 26.31倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	GoldmanSachs		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

## 經輝立證券申請截止認購日期

10月07日(二)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

**NEW**最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

## 基本資料

發行股數	228,696,000股
公開發售	22,870,000股
配售	205,826,000股
集資淨額	\$338,611,297美元 (HK\$11.68計算)
市值	HK\$11,528 – 12,613百萬港元
公開發售日	2014年10月03日-2014年10月08日
公開發售結果	10月14日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.38% (6日息)
上市日	10月15日
每手股數	1,000股

## 主要風險因素

- 倘華虹無法在華虹專注的特種應用方面保持技術領導者地位，或倘華虹無法及時應對快速變化的半導體市場動態，華虹的競爭力或會下降；
- 倘華虹不能持續保持高產能利用率、優化晶圓生產的產品組合及保持製成品率，華虹的利潤率或會大幅下滑；
- 華虹可能無法按合理成本及時取得華虹業務經營所需的工具及設備；
- 華虹或會依賴少數客戶，而任何客戶的銷售額減少或會對華虹的經營業績產生不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於擴充華虹的產能，具體為於設備、工具及設施的投資； 75%
- 將用於研發、技術及知識產權投資； 20%
- 將用於為華虹的營運資金及其他一般公司用途提供資金。 5%

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。